

京セラ株式会社 2015年3月期 第2四半期（上期） 決算説明会
（2014年10月31日実施）

代表取締役社長 山口 悟郎 スピーチ

<1. 2015年3月期 上期 決算概要（前年同期比）>

当上期の売上高は、前年同期に比べ2.1%増加の7,143億円となり、上期としては過去最高となりました。しかし、営業利益、税引前利益は、機器事業が増益となったものの、部品事業の減益をカバーするには至らず、減少しました。一方、四半期純利益は、国内の法人税率の引き下げによる税金費用の減少などにより、増益となりました。

当上期の設備投資額は、「ファインセラミック部品」及び「情報機器」関連事業を中心に前年同期に比べ増加しました。一方、減価償却費は「電子デバイス」、「ファインセラミック応用品」関連事業での減少を主因に前年同期を下回りました。また、研究開発費は「電子デバイス」や「情報機器」関連事業を中心に増加しました。

当上期の為替レートは、資料の下段にありますとおり、米ドルは前期に比べ4円円安の103円、ユーロは9円円安の139円となりました。この結果、前年同期に比べ、売上高に対しては約190億円、税引前利益に対し約50億円の押し上げ要因となりました。

**<スライド2：2015年3月期 上期 事業セグメント別売上高
（前年同期比）>**

セグメント別の売上高につきましては、「電子デバイス関連事業」や「通信機器関連事業」は減収となりましたが、部品事業、機器事業ともに増収となりました。特に「半導体部品関連事業」及び「情報機器関連事業」が大幅な増収となりました。

<スライド3：2015年3月期 上期 事業セグメント別事業利益

(前年同期比) >

セグメント別の利益については、「ファインセラミック応用品関連事業」の利益減が影響し、部品事業全体では減益となりましたが、「情報機器関連事業」の増益により機器事業全体では前年同期に比べ大幅に増加しました。

<スライド4：2015年3月期 上期決算要約(前年同期比) >

当上期決算の要約の1点目は、部品事業の拡大です。通信市場では、光通信や無線通信インフラ関連、スマートフォン向けのセラミックパッケージやコンデンサなどの売上が増加しました。自動車市場向けには、カメラモジュールやLED用セラミックパッケージ、機械工具の売上が伸びました。また、前期下期よりグループ入りした京セラ・サーキット・ソリューションズの寄与もあり、有機基板事業の売上が増加しました。

2点目は「情報機器関連事業」の拡大です。欧州やアジア地域を中心に、海外での複合機の販売が伸びたことにより、大幅な増収となりました。また、増収効果に加え、消耗品などの付加価値の高い製品の売上増によりプロダクトミックスが改善したことや、原価低減の効果により増益となり、2桁の利益率となりました。

3点目は「電子デバイス関連事業」の増益です。原価低減に加え、前期に実施した構造改革の効果もあり、減収ながらも増益となり、利益率も12%まで改善するなど、これまでに取り組んできた収益性向上に向けた施策の効果が見られました。

4点目は、「ファインセラミック応用品関連事業」の収益減です。ソーラーエネルギー事業では、前年同期には鹿児島七ツ島やタイをはじめとした大型案件がありましたが、当上期にはこのような大型案件の貢献が少なく、また、当期に入り、国内での競争激化により、製品価格の

下落が想定以上に進んだことが影響し、セグメント全体で減収減益となりました。

＜スライド5：2015年3月期 第2四半期 決算概要

（第1四半期比）＞

続いて、当第2四半期、3ヵ月間の実績を直近の第1四半期と比較し、ご説明いたします。

第2四半期の業績は、売上高、利益ともに2桁の増加となり、特に営業利益はほぼ2倍となる大幅な増益となりました。

なお、税引前利益は、第1四半期に受取配当金が計上されているため、営業利益の伸びに比べますと低くなっておりませんが、この受取配当金を除きますと、第2四半期の税引前利益は70%を超える増益となります。

また第2四半期の平均為替レートは、第1四半期に比べ米ドルが2円円安の104円、ユーロが2円円高の138円となりました。

＜スライド6：2015年3月期 第2四半期

事業セグメント別売上高（第1四半期比）＞

セグメント別の売上高については、全セグメントで第1四半期に比べ増収とすることができ、また、部品、機器の両事業ともに2桁の増収となりました。

＜スライド7：2015年3月期 第2四半期

事業セグメント別事業利益（第1四半期比）＞

セグメント別の利益についても、売上同様、全セグメントで増益とすることができました。特に「半導体部品」、「電子デバイス」、「通信機器」、「情報機器」関連事業の増益が大きく寄与しています。

結果として、グループ全体の事業利益は384億円となり、利益率は10.1%へ改善を図ることができました。

＜スライド8：2015年3月期 第2四半期

決算要約（第1四半期比）＞

続いて第2四半期の決算要約ですが、全セグメントが増収増益となり、事業利益は約6割の大幅増益となりました。

この業績拡大の要因の1点目は重点市場での売上増です。スマートフォン向けには「半導体部品関連事業」のCMOSイメージセンサー用や水晶・SAWデバイス用セラミックパッケージ、「電子デバイス関連事業」でのコネクタ、コンデンサなどの売上が大きく増加しました。

また、自動車をはじめとする産業市場向けでは、機械工具やカメラモジュールなどが伸びたことに加え、半導体製造装置用部品の売上も堅調に増加しました。

2点目は「通信機器関連事業」の収益増です。国内ではau様向けのトルク、海外ではベライゾン様向けのサファイア・シールドを搭載したブリガディア、Tモバイル様向けのハイドロ・ライフなど、当社の特長ある新製品の売上が寄与したことから、大幅な増収となりました。また、増収に加え原価低減の効果もあり、黒字転換しました。

3点目は「情報機器関連事業」の収益増です。欧州を中心にプリンター及び複合機の販売が増加し、大幅な増益となりました。

4点目は太陽電池需要の拡大です。第2四半期より国内産業用の売上貢献が本格化したことから、ソーラーエネルギー事業の売上が拡大しました。以上が第2四半期の決算要約です。

＜スライド9：2015年3月期 業績予想＞

続いて、業績予想について説明いたします。通期の売上、利益の予想は4月公表から変更はありません。

また、設備投資額、研究開発費の予想についても変更はありません。しかし、設備投資の実施時期が期初予定から総じてずれ込んでいるため、減価償却費は4月公表予想を60億円下回る見通しであります。

通期の為替レートは、上期実績と下期見通しを踏まえ、資料下段にあります通り米ドルを104円へ変更しました。なお、下期については、米ドルは105円、ユーロは135円を予想しています。

＜スライド10：2015年3月期 事業セグメント別売上高予想＞

セグメント別の売上高予想については、4月予想から変更はありません。

＜スライド11：2015年3月期 事業セグメント別事業利益予想＞

利益については、「ファインセラミック部品」、「電子デバイス」関連事業のセグメントで、4月予想に比べ原価低減による収益性の向上が見込まれ、今般、通期予想を上方修正いたしました。一方、「ファインセラミック応用品関連事業」については、売上は4月予想の達成を目指しますが、ソーラーエネルギー事業における国内住宅向けの売上拡大のための販促費の増加、及び競争激化の影響を主因に、4月予想を下回る見通しであります。

次に、各セグメントの下期の取り組みについて説明いたします。

＜スライド12：2015年3月期 セグメント別下期業績予想

ーファインセラミック部品関連事業ー

左側のグラフは、前期から今期予想を含めた半期毎のセグメントの業

績を示しています。上段が売上高、下段が事業利益及び利益率の推移です。右上の表は、当下期の業績予想を上期実績と比較した増減金額、増減率を示しています。

「ファインセラミック部品関連事業」では、上期に引き続き主要製品の伸びが業績拡大を牽引するものと見込んでおり、セグメント全体では上期に比べ10.5%の増収、14%の増益を予想しています。

特に、グロープラグなどの自動車関連部品や産業機械用部品の需要拡大が継続する見通しであり、これらの主要製品の売上増及び原価低減を進めてまいります。

＜スライド13：2015年3月期 セグメント別下期業績予想

－半導体部品関連事業－>

「半導体部品関連事業」では、売上、利益ともに上期に比べ2桁の大幅な増加を予想しています。

スマートフォン向けのCMOSセンサー用や水晶・SAWデバイス用セラミックパッケージの売上は、第3四半期にかけて増加する見通しです。加えて、中国での通信インフラ向けに光通信及び無線通信向けのセラミックパッケージや、有機FCBGAパッケージの売上が増加するものと予想しています。

また、有機基板事業については、今月より国内子会社2社を1社に統合しました。製造・販売面でのシナジー追求と経営のスピードアップを図り、新たな顧客開拓や新製品の提案を進めてまいります。

さらに、ベトナム工場での増産により、一層の原価低減を図ってまいります。

＜スライド14：2015年3月期 セグメント別下期業績予想

－ファインセラミック応用品関連事業－

「ファインセラミック応用品関連事業」は、上期に比べ売上は43%増、利益は約60%の大幅な増加を予想しています。

ソーラーエネルギー事業では、季節要因により産業用メガソーラー向けの工事が下期に本格化することから、上期に比べ大幅な販売拡大を見込んでいます。また、住宅向けには多結晶及び単結晶モジュールの拡販や、蓄電システム、HEMSといったシステムの売上拡大を図ります。

現在、電力会社5社の系統接続の回答保留により、先行きが見通しにくい状況にありますが、政府は年内に一定の結論を出すものと聞いております。この系統接続の影響はありますが、既に電力会社との接続認可を受けた案件も多くあり、また、住宅向けの拡販策を導入し、売上予想の達成に努めてまいります。

機械工具事業では、アジアをはじめ、自動車産業向けを中心に販売が堅調に拡大する見通しです。

利益については、ソーラーエネルギー事業での販売促進にともなうコスト増加の要因はありますが、各事業での売上増に加え、徹底した原価低減により、収益性を向上させてまいります。

＜スライド15：2015年3月期 セグメント別下期業績予想

－電子デバイス関連事業－

「電子デバイス関連事業」では、スマートフォンをはじめとするデジタルコンシューマ機器向けのコネクタや水晶関連部品の売上増や、産業機械向けの部品需要の伸びにより、上期比9.6%の増収を見込んでいます。

また、特にコンデンサ、水晶部品、ディスプレイ事業での収益性向上を図り、利益は2桁の増益を見込んでいます。

＜スライド16：2015年3月期 セグメント別下期業績予想

－通信機器関連事業－>

「通信機器関連事業」では、下期の売上は上期比約24%の増収、利益は109億円の大幅な改善を見込んでいます。

当上期は13億円の損失となりましたが、先ほどご説明しました通り、新モデルの貢献により、第2四半期では4%を超える利益率まで改善させることが出来ております。

下期については、国内外ともに上期以上に多くの新モデルの投入を計画しており、新製品の比率を高めることで収益性を向上させてまいります。また、海外事業については、引き続き大手の新規顧客開拓を進め、一層の顧客基盤の強化を進めてまいります。

＜スライド17：2015年3月期 セグメント別下期業績予想

－情報機器関連事業－>

「情報機器関連事業」では、下期の売上は12.5%の増収を見込んでいます。一方、下期は上期に対し4円のユーロ安・円高を想定していることに加えて、販売促進費の増加や減価償却費の増加を見込んでいます。また、主力の欧州市場の景気減速も懸念されることから、事業利益は上期比9億円の減少と保守的に予想しています。

下期においてはプリンター、複合機の新モデルを投入するとともに、一層の拡販活動を進めることにより、売上拡大を図ってまいります。

また、ベトナム工場の更なる活用やプラットフォーム化の推進により、原価低減に努めてまいります。

＜スライド18：2015年3月期 セグメント別下期業績予想

－その他の事業－>

「その他の事業」では、京セラコミュニケーションシステム(株)や京セラケミカル(株)を中心に売上を伸ばすとともに、原価低減により利益増を計画しています。以上が当下期の取り組みです。

＜スライド19：今後の取り組み（1）＞

続いて、中期的なグループの成長を図るうえで核となる、セラミックパッケージ事業、有機基板事業、電子デバイス関連事業、並びに自動車関連市場での今後の取り組みについて説明させていただきます。

まず、「セラミックパッケージ事業」ですが、今後のパッケージに対しては、左下にありますような小型・薄型化、多層化などの多くの市場要求があります。

今後の取り組みとしては、資料右側に示します「既存市場でのシェアアップ」を目指してまいります。特に通信端末向けについては、CMOSセンサー向けで有機材料からの置き換えを図ってまいります。セラミックの放熱性、薄型化や高い剛性といった特長を生かし、有機材料が主流となっているスマートフォン向けの搭載を拡げてまいります。

また、通信インフラ向けでは、中国での4G LTEへの投資が拡大しており、これに伴いデータ通信の高速化による光パッケージや無線通信用パッケージの需要が大きく伸びております。この需要を確実に捉え、売上拡大を図ってまいります。

さらに、もう1つの取り組みとして、左側の「新市場の開拓」を進めてまいります。特に車載、LED、医療市場での事業拡大を図ってまいります。車載用では、各種センサー用やECU基板の拡大を図るとともに、LEDパッケージについては、自動車のヘッドランプや照明用としての

成長機会を捉え、売上拡大を図ってまいります。

当社のセラミックパッケージ事業は既に高いマーケットシェアを有しておりますが、現在のNO. 1メーカーとしての地位に安住するのではなく、更なる事業の強化を目指してまいりたいと考えます。

<スライド20： 今後との取り組み（2）>

続いて「有機基板事業」ですが、本年10月より事業を一本化したことによるシナジーの最大化、経営基盤の強化により、事業拡大を目指してまいります。

資料左下の「営業部門の統合」により、パッケージからマザーボードまで、国内外のお客様に有機基板ソリューションを一括で提供し、事業拡大を図ってまいります。特に通信端末や通信インフラ、車載分野を重点市場と位置付け、取り組んでまいります。

また、資料右上の「生産体制の最適化」については、上期に京都・綾部新工場棟に新規設備の導入が完了しました。今後は既存の滋賀・野洲工場で生産しているFCCSPなどの製品の生産を新工場に移管し集約させ、最新の設備で生産性を高めてまいりたいと考えています。

さらに、資料右下の「経営管理の強化」については、さまざまなシステムを統一させ、経営効率のアップを追求してまいります。

<スライド21： 今後との取り組み（3）>

次に「電子デバイス関連事業」ですが、このグラフは前年と比較した主要プロダクトラインの売上高の増減を横軸に、利益の増減を縦軸に示しております。青色は、2014年3月期の売上・利益の増減実績を示しており、黄色は今期予想です。

青色で示します2014年3月期は、グラフの左側に位置している「京セラ電子部品」、「ディスプレイ」、「水晶部品」の3事業において構造改革を実施したことにより、売上は前年を下回りました。また、利益についても「ディスプレイ」と「水晶部品」事業は減少しました。一方、黄色の今期予想では、この3事業はいずれも大きく利益改善を図ることができる見通しであります。

今後は、これまで重点的に取り組んできた収益性の向上に加えまして、高付加価値製品の投入、並びに戦略的な新規顧客・市場開拓により、売上拡大を図ってまいりたいと考えています。

<スライド22： 今後との取り組み（4）>

自動車関連市場においては、当上期にグループを横断するプロジェクトチームを設立し、新製品・新規顧客開拓、製品の付加価値向上などの戦略的な取り組みを進めております。

中期目標である2017年3月期に、売上高3,000億円をめざし、Tier1メーカーとの取引拡大に加えて、自動車メーカーとのビジネス拡大を図ってまいりたいと考えます。

<スライド23： 経営目標>

当社はグループの総合力により、徹底した原価低減やM&Aを含めた外部の経営資源を活用し、既存製品のシェア向上、新製品開発・新市場開拓を強化してまいります。この結果として、グループの目標である、年率2桁の売上成長、税引前利益率10%以上をめざしてまいります。

以上